

レーザ微細加工技術の最新動向

近年、レーザ微細加工技術は、光源の高出力化・短パルス化、ビーム制御技術や加工プロセスの高度化により、精密加工の可能性を大きく広げています。金属加工をはじめとして、半導体、電子デバイス、医療機器、次世代材料加工など幅広い分野で応用が進み、研究・産業の両面で注目を集めています。本研究会では、レーザ微細加工技術に関する最新の研究成果や実用化事例を、第一線で活躍する4名の研究者と技術者から最新情報をご提供頂くとともに、今後の技術展開や課題について議論します。

主 催：公益社団法人砥粒加工学会 次世代固定砥粒加工プロセス専門委員会

日 時：2026 年 2 月 20 日(金) 13:00～17:00

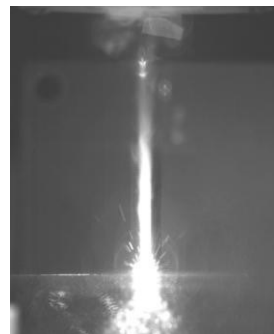
開催方式：下記会場（対面）と Cisco Webex Meeting（Web）の
ハイブリッド形式で開催します。

日本大学理工学部駿河台キャンパス 1号館 6階 CST ホール

URL：<https://www.cst.nihon-u.ac.jp/campus/surugadai/>

※ 講演者には開催前の状況により、対面か Web のどちらでの講演かを選択して頂きます。

※ Web 開催に関する詳細情報は、参加ご希望の方に後日通知いたします。



- | | | |
|-------------|---|-------------------------|
| 13:00～13:05 | 開会挨拶 | 委員長 日本大学 山田 高三 氏 |
| 13:05～13:55 | 講演 1 次世代レーザー加工に向けたデータ駆動型アクティブ制御レーザー加工技術開発 | 産業技術総合研究所 吉富 大 氏 |
| 13:55～14:45 | 講演 2 微細加工を行う選択枝としてのレーザという加工ツール | (株)アルプスエンジニアリング 刀原 寛孝 氏 |
| 14:45～15:05 | <休 憩> | |
| 15:05～15:55 | 講演 3 超短パルスレーザによる微細加工のご紹介と工程統合の可能性について | (株)リプス・ワークス 大竹 俊介 氏 |
| 15:55～16:45 | 講演 4 次世代半導体ガラス基板への微細レーザ加工 | 東京大学 物性研究所 小林 洋平 氏 |
| 16:45～16:55 | 閉会挨拶・事務連絡 | |
| 17:10～19:10 | 技術交流会（予定） | |

司会：森田 晋也（東京電機大学）、山田 洋平（埼玉大学）、小山 宏（日本工業出版）

参加費：研究会：当専門委員会会員：無料，非会員：15,400 円（税抜額 14,000 円＋消費税 1,400 円），非会員アカデミア：6,600 円（税抜額 6,000 円＋消費税 600 円），学生：無料

※会員は 5 人／社まで、非会員は 2 人／社まで研究会に参加できます。

技術交流会：会員資格に関わらず 2 名／社まで参加できます。3 人目からは 4,950 円／人（税抜額 4,500 円＋消費税 450 円）を徴収します。

（注）「会員」とは専門委員会会員を指します。学会員ではございませんのでご注意ください。

申込締切日：2026 年 2 月 6 日(木)

（注）当日キャンセルの非会員には、すでに準備に費用がかかっているため参加費を請求致します。

問合せ/申込先：当専門委員会事務局

・ FAX：048-858-3709, E-mail：sf-office@mech.saitama-u.ac.jp

・ 申し込みはホームページよりお願いいたします。→<https://jsat-sf.jp/event.html>